(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2003年10月23日 (23.10.2003)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 03/088335 A1

(51) 国際特許分類[7]: H01L 21/304

(21) 国際出願番号: PCT/JP03/04493

(22) 国際出願日: 2003年4月9日 (09.04.2003)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2002-112752 2002年4月15日 (15.04.2002) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社 荏原製作所 (EBARA CORPORATION) [JP/JP]; 〒144-8510 東京都 大田区 羽田旭町１１番１号 Tokyo (JP).

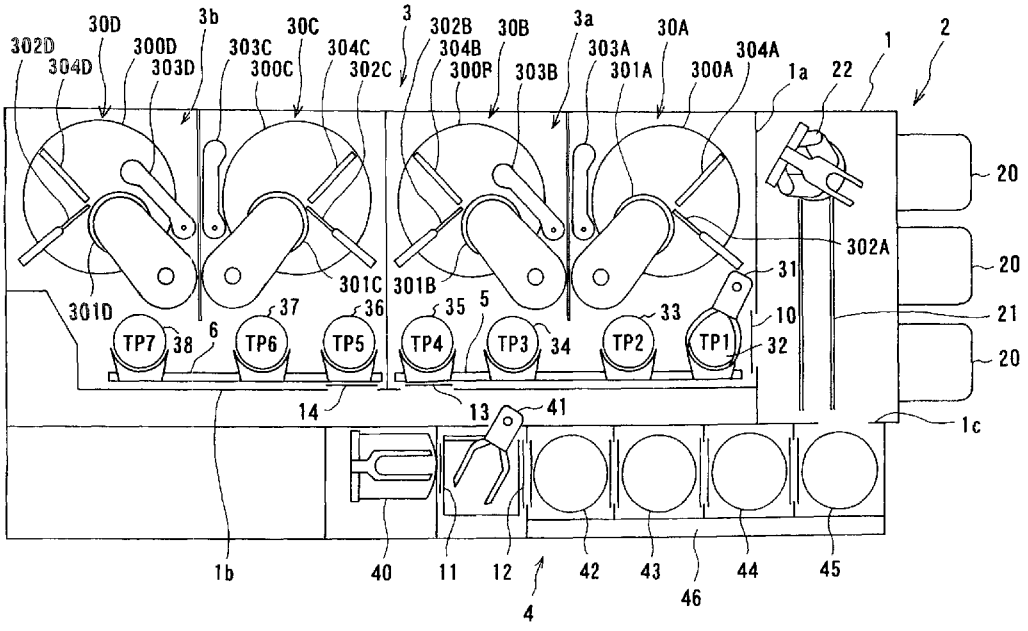
(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 若林 聡 (WAKABAYASHI,Satoshi) [JP/JP]; 〒144-8510 東京都 大田区 羽田旭町１１番１号 株式会社 荏原製作所 内 Tokyo (JP). 戸川 哲二 (TOGAWA,Tetsuji) [JP/JP]; 〒144-8510 東京都 大田区 羽田旭町１１番１号 株式会社 荏原製作所 内 Tokyo (JP). 小菅 隆一 (KOSUGE,Ryuichi) [JP/JP]; 〒144-8510 東京都 大田区 羽田旭町１１番１号 株式会社 荏原製作所 内 Tokyo (JP). 阿藤 浩司 (ATO,Koji) [JP/JP]; 〒144-8510 東京都 大田区 羽田旭町１１番１号 株式会社 荏原製作所 内 Tokyo (JP). 外崎 宏 (SOTOZAKI,Hiroshi) [JP/JP]; 〒144-8510 東京都

[続葉有]

(54) Title: POLISHING DEVICE AND SUBSTRATE PROCESSING DEVICE

(54) 発明の名称: ポリッシング装置及び基板処理装置



(57) Abstract: A polishing device, comprising a plurality of polishing units (30A to 30D), the polishing units further comprising moving mechanisms for moving top rings (301A to 301D) between a polishing position on a polishing surface and a wafer delivery position, linear transporters (5, 6) for transporting wafers between a plurality of transporting positions (TP1 to TP7) including the wafer delivery position, and pushers (33, 34, 37, 38) for delivering the wafers between the linear transporters (5, 6) and the top rings (301A to 301D) installed at the transporting positions (TP2, TP3, TP6, TP7) where the wafers are delivered.

(57) 要約: 本発明は、複数の研磨ユニット（３０Ａ～３０Ｄ）を備えたポリッシング装置であって、各研磨ユニットには、トップリング（３０１Ａ～３０１Ｄ）を研磨

[続葉有]

WO 03/088335 A1

大田区 羽田旭町１１番１号 株式会社 荏原製作所 内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 渡邉 勇，外(WATANABE,Isamu et al.); 〒160-0023 東京都 新宿区 西新宿７丁目５番８号 ＧＯＷＡ 西新宿４階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

面上の研磨位置とウェハの受け渡し位置との間で移動させる移動機構を設け、ウェハの受け渡し位置を含む複数の搬送位置（ＴＰ１～ＴＰ７）の間でウェハを搬送するリニアトランスポータ（５，６）を設け、ウェハの受け渡し位置としての搬送位置（ＴＰ２，ＴＰ３，ＴＰ６，ＴＰ７）には、リニアトランスポータ（５，６）とトップリング（３０１Ａ～３０１Ｄ）との間でウェハを受け渡すプッシャ（３３，３４，３７，３８）を設けた。